(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年3月28日(28.03.2024)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2024/062560 A1

(51) 国際特許分類:
G01R 1/067 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2022/035189

(22) 国際出願日： 2022年9月21日(21.09.2022)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(71) 出願人: 日本電子材料株式会社 (**JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION**) [JP/JP]; 〒6600805 兵庫県尼崎市西長洲町２丁目５番１３号 Hyogo (JP).

(72) 発明者: 武田 朋之 (**Takeda Tomoyuki**); 〒6600805 兵庫県尼崎市西長洲町２丁目５番１３号 日本電子材料株式会社内 Hyogo (JP).

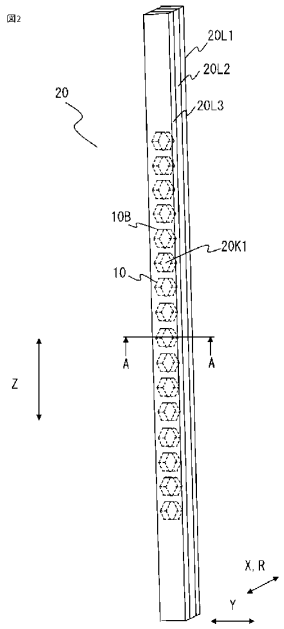
(74) 代理人: 弁理士法人ぱるも特許事務所 (**PALMO PATENT FIRM, P.C.**); 〒6610033 兵庫県尼崎市南武庫之荘３丁目３５番８号 Hyogo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,

(54) **Title:** PROBE FOR PROBE CARDS

(54) 発明の名称： プローブカード用プローブ



(57) **Abstract:** A probe (20) for probe cards, which is to be placed in contact with electrode pads of a semiconductor device and used for supply of power, input/output of signals, and grounding when performing an operation test of individual semiconductor devices formed on a wafer (W), comprises a plurality of three-dimensionally shaped stress-distributing chambers (201K) which are embedded inside the probe (20) and have vertices (10B) and ridges (10) formed by inner wall surfaces.

(57) 要約：ウエハ（W）上に形成された個々の半導体デバイスの動作テストを行うために、半導体デバイスの電極パッドに接触させて、電力の供給、信号の入出力、および接地を行うために使用されるプローブカード用のプローブ（２０）は、プローブ（２０）の内部に埋め込まれた、内壁面による稜線（１０）と頂点（１０Ｂ)とを有する立体形状の応力分散室（２０１Ｋ)を複数個備える。

WO 2024/062560 A1

［続葉有］

SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）